

日米半導体プログラムUPWARDSに基づく 米国Rochester Institute of Technology夏期滞在 TELとIBM訪問

(※) UPWARDS :

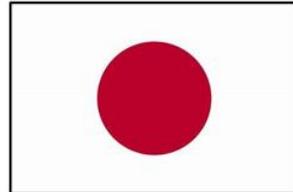
U.S. and Japan University Partnership for Workforce Advancement and Research
& Development in Semiconductors) for the future

半導体の人材育成と研究開発に関する未来に向けた日米大学間パートナーシップ

2024年4月15日

UPWARDS for the Future

University Partnership for Workforce Advancement and Research & Development in Semiconductors for the Future



- Boise State University
- Purdue University
- Rensselaer Polytechnic Institute
- Rochester Inst. of Technology
- Virginia Tech
- University of Washington
- Hiroshima University
- Kyushu University
- Nagoya University
- Tohoku University
- Tokyo Institute of Technology

A multi-university network between the U.S. and Japan that will increase the awareness of and opportunities in the global semiconductor ecosystem. These partnerships will focus on developing the next generation of the workforce, enabling fundamental and emerging research, with a priority to expand opportunities to female students, researchers and leaders.

❖ Curriculum Design and Implementation

classes specific to semiconductor design, process and development
delivered by faculty and industry leaders
shared across the network

❖ Women in Semiconductors

broaden access to global ecosystem
students, researchers and educator exchanges
mentorship and cohorts
summer camp

❖ Experiential Learnings

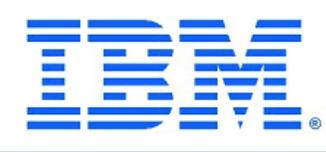
Cleanroom Seminars
Fab and Factory tours
Lab experiences

❖ Semiconductor and Memory Centric Research (non IP)

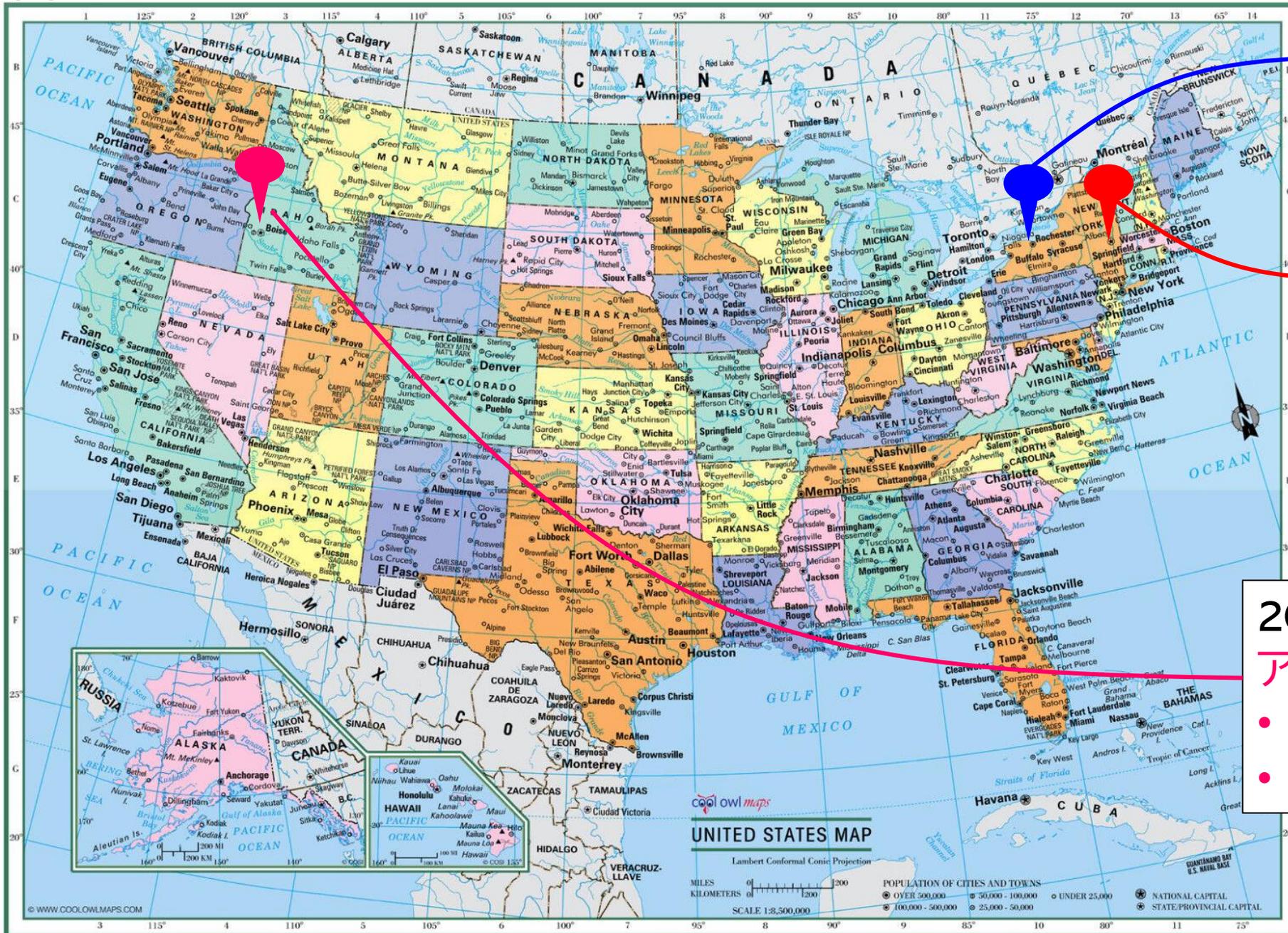
UPWARDS Faculty (named)
undergraduate and graduate researchers
Symposiums

日程

全行程：8/8出発（確定）-8/29帰国（仮）

日付	場所	内容	負担金額
8/8	移動（出国）		航空券代は九大から支給。 要立替。事後清算。
8/9-23	Rochester Institute of Technology 	半導体セミナー、CR体験実習、基礎から応用まで広範囲なコース	コース受講費・食費・宿泊費・学内施設利用と移動は九大支給。 立替え不要。
8/24, 25	移動＋休日		航空券代は九大から支給。 要立替。事後清算。
8/26	東京エレクトロン 	米国の技術センター訪問見学	宿泊費・食費は九大旅費規程に則り支給。 要立替。事後清算。
8/27	IBM 	訪問見学	宿泊費・食費は九大旅費規程に則り支給。 要立替。事後清算。
8/28-29	移動（帰国）		航空券代は九大支給。 要立替。事後清算。

滞在先



2024年夏
NY州のRochester
• Rochester Institute of Technology
NY州のAlbany
• 東京エレクトロニクス
• IBM

2023年春
アイダホ州のBoise
• Boise State University
• Micron本社

(参考)九大旅費規程

<https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/638/1/2004syuki057.pdf>

別表第7 (第29条関係)

(単位：円)

区 分		日当 (1日につき)	宿泊料 (1夜につき)	食卓料 (1夜につき)
国内出張旅費		1,700	8,200	1,700
外国出張旅費	甲 地	4,800	14,700	4,800
	乙 地	3,400	10,200	